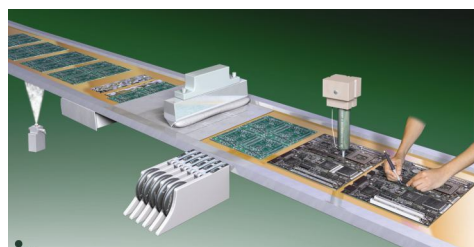


## Приглашение на семинар

*«Современные решения, материалы и подходы в организации сборочно-монтажного производства. Борьба за качество и производительность. Отмывка печатных узлов. Защита электроники от внешних воздействий. Перспективные материалы и оборудование»*

Уважаемые разработчики и производители электроники!

ЗАО Предприятие Остек приглашает вас 09 и 10 октября 2012 г. принять участие в большом двухдневном семинаре, который пройдет в Екатеринбурге. Основная тема семинара – самые современные подходы, решения и материалы для производства электроники. Мы подробно рассмотрим решения задач по сборке, пайке, отмывке и защите печатных узлов.



Основные вопросы семинара:

### «Сборка электроники»

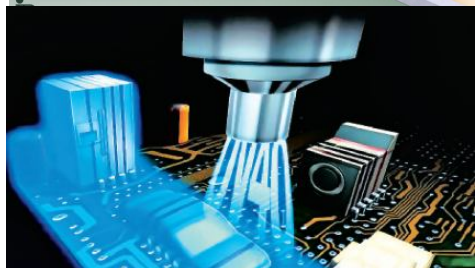
- Современные подходы в организации сборочно-монтажного производства техники.
- Системы учета и прослеживаемости.
- Особенности технологии Pin-in-Paste и использования преформ.
- Материалы для пайки: рекомендации по выбору и применению.

### «Отмывка электроники»

- Типы загрязнений и чем они опасны.
- Выбор технологии отмывки и отмывочной жидкости.
- Контроль качества отмывки и состояния отмывочной жидкости.

### «Защита электроники от внешних воздействий»

- Виды внешних воздействий и способы защиты.
- Материалы для влагозащиты Dow Corning и HumiSeal.
- Автоматизация и механизация процессов нанесения материалов.



- Обеспечение теплового режима работы электронных приборов.

## Участие в семинаре бесплатное!

Вы можете принять участие как в одном из дней, так и в двух (обязательно укажите это при регистрации). Подробно тематика каждого дня представлена в программе семинара.

### Место и время проведения:

ООО «Маринс Парк Отель». Адрес: г. Екатеринбург, ул. ул. Челюскинцев 106, метро «Уральская». 09 – 10 октября 2012 г., с 9:30 до 18:00 часов.

Вы можете зарегистрироваться на участие в семинаре любым из способов:

- по электронной почте [info@ostec-group.ru](mailto:info@ostec-group.ru)
- по телефону (495) 788-44-44
- заполнив форму заявки на сайтах [www.ostec-group.ru](http://www.ostec-group.ru), [www.ostec-materials.ru](http://www.ostec-materials.ru)

**Будем рады видеть вас в числе участников семинара!**

**ПРОГРАММА СЕМИНАРА**  
**(09-10 октября 2012 г., Екатеринбург)**

**«Современные решения, материалы и подходы в организации сборочно-монтажного производства. Борьба за качество и производительность»**  
**09 октября 2012, г.**

<b>Время</b>	<b>Мин.</b>	<b>Наименование доклада</b>	<b>Докладчики</b>
<b>09:30 - 10:00</b>	<b>30</b>	<b>Регистрация участников. Вступительное слово</b>	
10:00 – 11:00	60	Современные технологии пайки оплавлением (конвекционная и конденсационная пайка) Особенности оборудования и практической реализации в отечественных условиях.	Завалко А.В.
<b>11:00 – 11:20</b>	<b>20</b>	<b>Кофе-брейк</b>	
11:20 – 12:00	40	Построение системы учета и прослеживаемости плат и комплектующих при производстве изделий электроники	Завалко А.В.
12:00 – 12:40	40	Обращение с паяльной пастой. Как не испортить паяльную пасту? Нанесение паяльной пасты. Основные принципы получения повторяемого качественного результата.	Баев С.В..
12:40 – 13:20	40	Очистка оборудования и трафаретов – залог повторяемости	Завалко А.В. Баев С.В.
<b>13:20 – 14:20</b>	<b>60</b>	<b>Обед</b>	
14:20 – 15:20	60	Особенности технологии Pin-in-Paste (установка с последующей пайкой компонентов в отверстия на паяльную пасту). Материалы и преформы. PIP+	Завалко А.В. Баев С.В.
<b>15:20 – 15:40</b>	<b>20</b>	<b>Кофе-брейк</b>	
15:40 – 16:30	50	Особенности работы с BGA, малыми чипами, компонентами, чувствительными к влаге и нагреву	Завалко А.В.
16:30 – 17:30	60	Контроль качества в производстве электронных изделий	Зверев М.С.
<b>17:30 – 17:40</b>	<b>10</b>	<b>Подведение итогов и ответы на вопросы</b>	

**«Отмывка печатных узлов. Защита электроники от внешних воздействий. Перспективные материалы и оборудование»**  
**10 октября 2012, г.**

<b>Время</b>	<b>Мин.</b>	<b>Наименование доклада</b>	<b>Докладчики</b>
<b>09:30 - 10:00</b>	<b>30</b>	<b>Регистрация участников. Вступительное слово</b>	
10:00 – 10:20	20	Остатки флюса – почему остаются, какие и что они в себе несут? Как выбрать группу совместимых материалов?	Баев С.В.
10:20 – 11:40	80	Отмывка печатных узлов.	Савельев А.А.
<b>11:40 – 12:00</b>	<b>20</b>	<b>Кофе-брейк</b>	
12:00 – 12:20	20	Оборудование для отмывки электроники	Завалко А.В.
12:20 – 13:20	60	Повышение производительности процессов нанесения материалов. Автоматизация и механизация процессов нанесения материалов. Оборудование Fisnar. Типы оборудования, возможности оборудования, примеры решённых задач.	Савельев А.А.
<b>13:20 – 14:20</b>	<b>60</b>	<b>Обед</b>	
14:20 – 14:40	20	Виды внешних воздействий и способы защиты электроники. Типовые задачи, стоящие перед разработчиками и производителями. Типы защитных материалов. Классификация.	Савельев А.А.
14:40 – 15:30	50	Влагозащита печатных узлов. Типовые задачи. Материалы Dow Corning и HumiSeal . Рекомендации по применению. Ремонт.	Савельев А.А.
<b>15:30 – 15:50</b>	<b>20</b>	<b>Кофе-брейк</b>	
15:50 – 16:30	40	Оборудование для селективного нанесения влагозащиты.	Завалко А.В.
16:30 – 17:00	30	Обеспечение теплового режима работы электронных приборов. Склеивание, заливка, герметизация. Материалы Dow Corning/ Типовые задачи и решения. Ремонт и доработка.	Савельев А.А.
<b>17:00 – 17:15</b>		<b>Ответы на вопросы</b>	